

技術詞彙

本技術詞彙載有本文件所使用有關本公司以及本文件所使用有關我們業務或我們的若干詞彙的解釋。該等詞彙及獲賦予的涵義未必與業界的標準定義相同。

「鋁基線」	指	本集團於往績記錄期間開發、製造及銷售的由約99.99%鋁鍵合綫及約99.0%硅鋁鍵合綫構成的鍵合綫
「退火」	指	轉變材料物理屬性以增加其柔軟性及降低其硬度的熱處理方法，使其更好使用及更易切割及塑形
「背光」	指	一種從後面照明物體的光源
「BGA」	指	球柵陣列的英文簡稱，是一種IC所用的表面貼裝封裝機
「鍵合綫」	指	直徑介乎於0.7毫米至3.2毫米的由本集團於往績記錄期間開發、製造及銷售的鍵合綫，包括(i)金線；(ii)金銀合金線；(iii)銅基線；及(iv)鋁基線
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「相機模組」	指	鏡頭部件及傳感器或其他部件(如PCB)的光電組裝具有包括CSP及COB等各類封裝技術。相機模組用於日後捕獲被傳輸的圖像或存儲於含有模組的電子設備中
「無塵室」	指	通常用於製造或科研的一種環境，其灰塵、空氣微生物、懸浮顆粒及化學蒸汽等環境污染指數低
「無塵室1,000級」	指	容納每立方米約35,000顆粒徑在0.5微米或更大顆粒的無塵室
「無塵室10,000級」	指	容納每立方米約350,000顆粒徑在0.5微米或更大顆粒的無塵室

技術詞彙

「無塵室100,000級」	指	容納每立方米約3,500,000顆粒徑在0.5微米或更大顆粒的無塵室
「COB」	指	板上芯片的英文簡稱，為一種將無塗層半導體元件直接黏貼在印製電路板上的工序
「銅基線」	指	本集團於往績記錄期間開發、製造及銷售的由約99.99%銅鍵合綫、約97.0%銅合金鍵合綫及約98.0%鍍鈀銅基綫構成的鍵合綫
「CSP」	指	晶片規格封裝的英文簡稱，為半導體封裝規格，封裝大小不超過半導體模具的1.2倍
「晶片」	指	從晶圓上切割的未進行封裝的獨立晶片
「封裝膠」	指	本集團於往績記錄期間所開發、製造及出售粘度介乎400毫帕·秒至80,000毫帕·秒的封裝膠，包括(i)COB用高純度液態COB環氧樹脂封裝膠；(ii)室內及戶外LED封裝用的LED環氧樹脂，低粘、高耐紫外光及耐高溫性能；(iii)LED照明、背光及燈絲用的LED封裝硅膠，具有高粘合性、中等強度及高熱穩定性；及(iv)固晶膠
「FBGA」	指	細間距球柵陣列的英文簡稱，乃一種基底壓制晶體度包裝，經塑膜封裝及細間距鍵合工具點排列
「金線」	指	本集團於往績記錄期間所開發、製造及出售純度約99.99%金鍵合綫
「金銀合金綫」	指	本集團於往績記錄期間所開發、製造及出售由純度約60%至80%的金合金鍵合綫及純度約88%至98%的銀合金鍵合綫組成的鍵合綫
「IC」	指	集成電路的英文簡稱，由若干電晶管及電子電路於硅芯片上組成的半導體設備

技術詞彙

「ISO」	指	國際標準化組織的英文簡稱，一個制訂國際標準的機構，由多個國家標準機構之代表組成
「公斤」	指	公斤
「千米」	指	千米
「LED」	指	發光二極管的英文簡稱，一種半導體光源，於流動電話、電腦、電視機、交通燈、電燈、路燈等不同裝置上用作照明
「毫寸」	指	千分之一寸之測量單位
「毫帕·秒」	指	毫帕·秒，動力粘度的測量單位
「PCB」	指	印製電路板的英文簡稱，電子元器件的支撐體及電氣連接的載體，製作方法為在銅片上蝕刻出導電圖面、線路或信號線並貼壓於絕緣基板
「研發」	指	研發的英文首字母縮略詞
「REACH」	指	化學品註冊、評估、許可和限制的英文簡稱，為歐盟所採納用以保護人體健康及環境免受化學品所帶來的危險的法規，於2007年生效
「RoHS」	指	歐洲議會及執行委員會關於限制在電子電器設備中使用某些有害成分的指令的英文縮寫，內容有關(其中包括)化學品註冊、評估、許可和限制
「熔煉」	指	一種提取冶金形式，旨在自礦石生產基底金屬，如自礦石生產銀、鐵、銅及其他基底金屬
「平方米」	指	平方米
「繞綫」	指	在物件(如電樞)上繞綫或盤繞材料(如線)